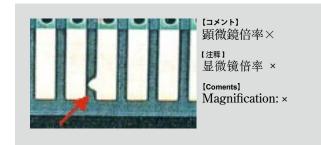
【原因・判断ポイント・発生工程】現像工程でDFRの剥離片が板面に再付着して、ETレジストとなったことにより出来たもの(現像 \sim ET工程)

【原因、判断要点、发生工序】在显影工序,DFR 剥离片再次附着在板面,成为 ET 剂而引起的(显影~ET 工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment]

A piece of peeled dry film is attached again to the base material and acts as an etching resist. (Developing - etching process)



1-5-1-4 ヘドロ突起/粘性污泥的凸出 / Projected conductor by sludge

【特徴】回路導体と同一面のシャープな丸みを持った突起、形状はまちまちである

【特征】在线路面有轮廓清晰的圆角的凸出,形状各异。

[Characteristics] Awell defined and rounded projection of the same thickness as that of the conductor. Shapes vary.

【原因・判断ポイント・発生工程】回路導体となる 銅めっき面に、ヘドロが付着し、これが E T レジス トとなった為にできたもの(現像~ E T 工程)

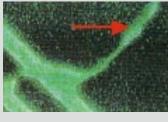
【原因、判断要点、发生工序】在导线的镀铜面附着 粘性污泥,成为 ET 剂而引起的(显影~ ET 工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment] Sludge attached on the plated copper surface acts as an etching resist and causes the defect. (Developing etching process)



ロメント) 顕微鏡倍率× は乗1 显微镜倍率×





顕微鏡倍率×

[注釋]
显微镜倍率 ×

[Coments]

Magnification: ×



[コメント] 顕微鏡倍率× [注釋] 显微镜倍率 × [Coments] Magnification: ×



ロメント) 顕微鏡倍率× I注釋I 显微镜倍率 × [Coments] Magnification: ×